LIGHT-EMITTING ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Publication number: JP2002043054
Publication date: 2002-02-08

Inventor:

SHIRASAKI TOMOYUKI; OZAKI TAKESHI; OKADA

OSAMU

Applicant:

CASIO COMPUTER CO LTD

Classification:

- international:

H01L51/52; H01L51/50; (IPC1-7): H05B33/02;

H05B33/04; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22

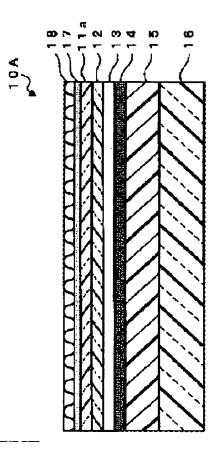
- european:

Application number: JP20000225447 20000726 Priority number(s): JP20000225447 20000726

Report a data error here

Abstract of JP2002043054

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting element, capable of restricting generation of fuzziness of image, in the case of using as a display device and the generation of parallax displacement, when using as the backlight of a transmission-type display device, while improving the outgoing light quantity (light-emitting effi ciency) of an organic EL element, and to provide a method of manufacturing this light-emitting element. SOLUTION: An anode electrode 12 formed of a transparent electrode such as ITO, an organic EL layer 13 made of the organic compound, and a cathode electrode 14 forming a reflecting layer are laminated in the order on one surface of a transparent insulating substrate 11a formed thin at about 0.2 mm or less (desirably, 0.1 mm or less) for the plate thickness so as to form an organic EL element. A sealing substrate 16, having a relatively thick plate thickness and facing the insulating substrate 11a, is provided via a sealing layer 15 which covers the whole surface of the organic EL element, and a scattering plate 18 is provided in the other surface of the insulating substrate 11a, so as to maintain continuity of the refractive index.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2002-43054 (P2002-43054A) (43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

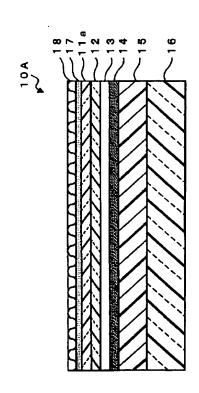
(51) Int. C1.	举 则纪.		FI		テーマコード(参考)	
H 0 5 B	33/02	j	H 0 5 B	33/02	3K007	
	33/04			33/04		
	33/10			33/10		
	33/14			33/14	A	
	33/22			33/22	Z	
	審査請求 未請求 請求項の数10	OL			(全16頁)	
(21)出願番号	特願2000-225447(P2000-225447)		(71)出願人	00000	1443	
(21) Щиж 🖽 .)	10 M9(2000 22011) (12000 22011)		(11) [1109()]			
(0.0) HIEE E	T-0.0 T-0.0 T-0.00 T-0.00				計算機株式会社	
(22)出願日	平成12年7月26日(2000.7.26)			東京都渋谷区本町1丁目6番2号		
•		- '	(72)発明者	白嵜	友之	
				東京都	3八王子市石川町2951番地の5 :	カシ
				オ計算	「機株式会社八王子研究所内	
			(72)発明者	尾崎	剛	
				東京都	3八王子市石川町2951番地の5 :	カシ
					[機株式会社八王子研究所内	•
			(7.4) (L) THI I			
		'	(74)代理人			
				弁埋士	: 鹿嶋 英實	
					最終頁に	続く

(54) 【発明の名称】発光素子およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 有機EL素子における出射光量(光の取り出 し効率)の向上を図りつつ、表示デバイスとして適用し た場合の像ぼけや、透過型表示デバイスのバックライト として適用した場合の視差ずれを抑制することができる 発光素子及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 概ね板厚0.2mm以下(好ましくは、 0. 1 mm以下) に薄く形成された透明な絶縁性基板 1 1 a の一面側に、ITO等の透明電極からなるアノード 電極12と、有機化合物等からなる有機EL層13と、 反射層を構成するカソード電極14とを順次積層して有 機EL素子を構成し、該有機EL素子の全面を覆う封止 層15を介して、絶縁性基板11aに対向する比較的板 厚が厚い封止基板16を設けるとともに、絶縁性基板1 1 a の他面側に、屈折率の連続性を保つように散乱板 1 8を設けた構成を有している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性の透明基板の一面側に、透明な導 電性材料からなる第1の電極と、有機エレクトロルミネ ッセンス材料からなる発光層と、前記第1の電極に対向 する第2の電極が順次積層された面状構造を有する発光 素子において、

前記透明基板の厚みが、概ね0.2mm以下であること を特徴とする発光素子。

【請求項2】 前記透明基板上に積層された前記第1の 電極、前記発光層、前記第2の電極は、封止部材により 10 封止されていることを特徴とする請求項1記載の発光素 子。

【請求項3】 前記発光層から放射される光の出射方向 を変更制御する光制御手段を設けたことを特徴とする請 求項1又は2記載の発光素子。

【請求項4】 前記光制御手段は、前記透明基板の他面、 側に密着するように設けられ、該密着面での屈折率は、 前記透明基板の屈折率と同一又は近似していることを特 徴とする請求項3記載の発光素子。

【請求項5】 前記透明基板の一面側に、前記透明基板 20 に対向する対向基板を設けたことを特徴とする請求項1 乃至4のいずれかに記載の発光素子。

【請求項6】 前記対向基板は、0.4mm以上のガラ ス又は合成樹脂基板からなることを特徴とする請求項5 記載の発光素子。

【請求項7】 前記対向基板は、前記透明基板上の前記 第1の電極及び前記第2の電極に電圧を印加する駆動回 路が設けられていることを特徴とする請求項7又は8記 載の発光素子。

【請求項8】 前記発光層の周囲の前記透明基板と前記 30 対向基板との間はシール部材により接合され、前記シー ル部材、前記透明基板及び前記対向基板に囲まれた空間 には、封止部材が設けられていることを特徴とする請求 項5乃至7のいずれかに記載の発光素子。

【請求項9】 絶縁性の透明基板の一面側に、透明な導 電性材料からなる第1の電極と、有機エレクトロルミネ ッセンス材料からなる発光層と、前記第1の電極に対向 する第2の電極を順次積層する工程と、

前記透明基板上に積層された前記第1の電極、前記発光 層、前記第2の電極の全面を、少なくとも封止部材によ 40 り固体的に封止する工程と、

前記透明基板の他面側を研磨して、前記透明基板の厚み を概ね0.2mm以下にする工程と、を含むことを特徴 とする発光素子の製造方法。

【請求項10】 前記研磨された前記透明基板の他面側 に、前記発光層から放射される光の出射方向を変更制御 する光制御手段を密着する工程を有していることを特徴 とする請求項9記載の発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光素子およびそ の製造方法に関し、特に、有機エレクトルミネッセンス 材料による発光層を備えた面状構造の発光素子及びその 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、高度情報化社会の進展に伴い、コ ンピュータや携帯電話、携帯情報端末等の情報通信機器 の普及が著しい。このような情報通信機器においては、 入出力インターフェースとして表示デバイスが大きな役 割を果たしている。そして、表示デバイスとしては、近 年、ブラウン管(CRT)の代替えとして、液晶表示パ ネル(LCDパネル)が急速に普及している。

【0003】その一方で、薄型の表示デバイスとして、 有機化合物を発光材料とする有機エレクトロルミネッセ ンス (Electroluminescence) 素子 (以下、「有機EL 素子」と略記する)が実用化に向けて研究開発されてい る。ここで、LCDパネルは、バックライトの光により 画像情報を表示する非発光素子(透過型の表示デバイ ス) であるのに対して、有機EL素子は、有機化合物を 発光層に用いた自己発光型の表示デバイスであるため、 次に示すような種々の特徴を有している。

【0004】例えば、LCDパネルに比べて視野角が広 く、コントラストや視認性に優れている。また、LCD パネルのようなバックライトが必要ないため、一層の薄 型、軽量化が実現できるうえ、直流低電圧駆動が可能で あり、応答速度も極めて速いという特徴を有している。 さらに、有機EL素子をLCDパネル等の透過型の表示 デバイスのバックライトとして適用した場合には、通常 の冷陰極管によるものに比較してより小さいエネルギー で同等の光量を得ることができ、消費電力を低減するこ とができるという特徴を有している。加えて、素子構造 が全て固体であるため振動に強く、適用範囲が広い等の 特徴を有している。このような種々の特徴を有している ことから、有機EL素子は、次世代の表示デバイスある いは光源として非常に注目されている。

【0005】図13に、従来技術における有機EL素子 の概略構成を示し、その構造について説明する。図13 (a) に示すように、有機EL素子10は、大別して、 ガラス基板等の透明な絶縁性基板11の一面側に、IT O (Indium Thin Oxide) 等の透明電極材料からなるア ノード電極12と、有機化合物等の発光材料からなる有 機EL層13と、金属材料からなる反射特性を有するカ ソード電極14と、を順次積層した構成を有している。 そして、上述したような有機EL素子10は、封止層1 5及び封止基板16(又は、不活性ガスを充填したキャ ップ封止)により封止、密閉され、外気から遮断された 構成を有している。このような有機EL素子を封止する 構成については、例えば、特開2000-3782号公 報や特開2000-173766号公報等に記載されて

50 いる。また、有機EL層13は、図13(b)に示すよ

うに、例えば、高分子系のホール輸送材料からなるホー ル輸送層13aと、高分子系の電子輸送性発光材料から なる電子輸送性発光層13bを積層して構成されてい る。

【0006】このような構成を有する有機EL素子10 において、図13(b)に示すように、直流電圧源から アノード電極12に正電圧、カソード電極14に負電圧 を印加することにより、ホール輸送層13aに注入され たホールと電子輸送性発光層13bに注入された電子が 有機EL層13内で再結合する際のエネルギーに基づい 10 て光が放射される。そして、この光 h ν は、透明なアノ ード電極12を透過して絶縁性基板11の他面側に放出 される。このとき、光hνの発光強度は、アノード電極 12とカソード電極14間に流れる電流量に応じて制御 される。

【0007】ところで、上述したような有機EL素子1 0においては、発光層となる有機EL層13において放*

 $\sin \alpha / \sin \delta = 1$. 0008/1. 60

【0009】したがって、図14(b)に示すように、 絶縁性基板11からの光L0、L11、L12の出射角 20 度 δ が各 ϕ 0°、45°、75°の場合における有機E L層13における放射角度αは、 0° 、 26.3° 、37. 2° となる。ここで、これら放射角度 α 、出射角度 δは、有機ΕL層13の発光面への垂線を軸とした角度※

 $\alpha_{L} = \sin^{-1} (\sin 9.0^{\circ} \times 1.0008 / 1.60)$

 $\alpha_L = 38.7$ °

【0010】なお、全反射臨界角 α_L (= 38.7°) 以上の角度αで放射される光L14、L15は、有機E L層13、アノード電極12及び絶縁性基板11の屈折 率に基づいて、各々絶縁性基板11の上面、及び、アノ ード電極12と絶縁性基板11の界面において反射した 後、有機EL素子内で反射を繰り返す。を有する

 $\theta = 2 \pi \times (1 - \cos 3 8. 7^{\circ})$

 $= 0.44 \pi$

【0012】これにより、有機EL層13における全発 光量に対する視野側への出射光量(取り出し効率)は、 有機EL層13から直接絶縁性基板11を介して出射さ れる前面出射光束と、有機EL層13からカソード電極☆ *射される光が、有機EL層13からアノード電極12及 び絶縁性基板11を介して、あるいは、カソード電極1 4で反射して有機EL層13、アノード電極12及び絶 縁性基板11を介して、絶縁性基板11の他面側、すな わち、視野側に出射されることになる。そのため、有機 EL素子10を構成する各層の屈折率に応じて、全体の 発光量に対する視野側への出射光量(取り出し効率)が 一義的に決まる。

【0008】具体的には、有機EL層13の屈折率を 1. 60、アノード電極12を構成するITOの屈折率 を2.00、絶縁性基板11を構成するガラスの屈折率 を1.45、視野側の空気の屈折率を1.0008とし た場合、有機EL層13から放出される光の進路(放 射、出射角度)は、図14(a)に示すように、上記各 層の屈折率によって決まるため、有機EL層13におけ る放射角度αと絶縁性基板11からの光L0、L11~ L15の出射角度 δ との関係は、次式により表される。 $\cdot \cdot \cdot (1)$

※であり、絶縁性基板11からの光の出射角度δが限界 (すなわち、出射角度δ=90°:光L13に相当)と なる有機EL層13における放射角度(全反射臨界角) α_L は、上記(1)式に基づいて、次式のように求めら れる。

 $\cdot \cdot \cdot (2)$

★【0011】一方、有機EL層13から放射される光 は、全周の全角度に対して均一な光束を出射する完全拡 散型の放射特性を有しているので、図15に示すよう 30 に、絶縁性基板11から光が出射される角度範囲(0~ 90°)の球冠の立体角θは、上記全反射臨界角α μ = 38.7°に基づいて、次式のように表される。

 $\cdot \cdot \cdot (3)$

☆14において反射し、絶縁性基板11を介して出射され る後面出射光束との和に基づいて、次式のように求めら れる。

取り出し効率=(前面出射光束+後面出射光束)/全光束

 $= 0.44 \pi \times 2/4 \pi$

= 0.22 (= 22%)

 \cdots (4)

【0013】上述したように、従来の有機EL素子10 においては、絶縁性基板11と空気の屈折率の差が大き いために、各層の界面において反射又は全反射を繰り返 して減衰する成分が多くなり、有機EL層において放射 された光のうち、約20%程度が視野側に出射されるに すぎなかった。そのため、このような問題を解決するた めに、例えば、電極層や有機EL層の平面構造を変化さ せた構成により、視野側における正面輝度を改善するこ

上の種々の課題を解決しなければならいという問題を有 している。

【0014】そこで、図16に示すように、絶縁性基板 11の他面側に散乱板(拡散性を有するフィルム等)1 8を配置するとともに、カソード電極14を構成する金 属層の反射率を高く設定することにより、上記取り出し 効率を向上する構成が知られている。このような構成を 有する有機EL素子においては、絶縁性基板11の界面 とが提案されているが、新たな構造に伴う製造上や特性 50 において光が反射又は全反射する角度が散乱板18によ

5

る散乱によって変化するため、カソード電極で反射した 光が視野側に出射される確率が高くなり、光の取り出し。 効率を向上させることができる。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したような有機EL素子においては、次に示すような問題点が提起されている。

(1) 有機EL素子を構成する絶縁性基板は、製造時における各種処理工程や搬送時における外部応力による破損を防止する強度を備え、また、有機EL素子を発光駆動するための駆動回路(ドライバIC)等を良好に搭載するために、例えば、0.4~0.7mm程度の比較的厚い板厚を有している。

【0016】そのため、有機EL素子自体を所望の画像情報を表示する表示デバイスとして適用した場合、図17(a)に示したように、有機EL層13において放射された光の進路が各層の屈折率および絶縁性基板11の板厚に応じて広がることになるため、表示画素や画像の輪郭2aが霞んで、いわゆる、画素ぼけ、あるいは、像ぼけが発生するという問題を有していた。

【0017】(2)また、有機EL素子をLCDパネル等の透過型の表示デバイスの背面側に配置して、屋外等の明視野の環境下では、カソード電極により外光を反射する反射パネルとして使用するとともに、屋内等の暗視野の環境下では、発光駆動してバックライトとして使用する、いわゆる、2ウェイバックライト(2 Way BackLight)として適用する場合には、次のような問題点を有している。

【0018】すなわち、図17(b)に示すように、有機EL素子10をLCDパネル50の反射パネルとして 30使用する場合においては、LCDパネル50に表示された画像Zbの反射像Rbがカソード電極14上で形成されるとともに、絶縁性基板11の上面においても部分的な反射によって薄い反射像Rcが形成されるため、表示画像に陰が付加されたような二重像Zc、いわゆる、視差ずれが発生するという問題を有していた。このような問題点(1)、(2)は、絶縁性基板の板厚が厚くなるほど顕著になるが、上述したように、製造工程や表示デバイスの構成(有機EL素子の封止構造やドライバICの搭載等)上、絶縁性基板を薄くすることには限界があ 40った。

【0019】そこで、本発明は、このような問題点を解決することを目的とし、有機EL素子における出射光量(光の取り出し効率)の向上を図りつつ、表示デバイスとして適用した場合の像ぼけや、透過型表示デバイスのバックライトとして適用した場合の視差ずれを抑制することができる十分な機械的強度の発光素子及びその製造方法を提供するものである。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明に係る発光素子

は、絶縁性の透明基板の一面側に、透明な導電性材料からなる第1の電極と、有機エレクトロルミネッセンス材料からなる発光層と、前記第1の電極に対向する第2の電極が順次積層された面状構造を有する発光素子において、前記透明基板の厚みが、概ね0.2mm以下であることを特徴とする。

【0021】すなわち、出射光側となる透明基板を薄く構成(概ね0.2mm以下、好ましくは、0.1mm以下に)することにより、本発明に係る発光素子を自己発光型の表示デバイスに適用した場合には、発光層から出射面(透明基板の他面側)までの距離が短くなり、発光層から放射された光の進路の拡がりが抑制される。したがって、表示画素のぼけ(像ぼけ)を抑制することができ、画質を向上した表示デバイスを実現することができる。

【0022】また、本発明に係る発光素子を透過型表示デバイスの2ウェイバックライトとして適用した場合においては、透明電極の上面から反射層となる第2の電極までの距離が短くなり、透過型表示デバイスに表示された画像の反射像のずれや重なりが抑制される。したがって、視差ずれを抑制することができ、画質を向上した表示デバイスを実現することができる。

【0023】また、本発明に係る発光素子は、上記発光素子の構成において、前記透明基板上に積層された前記第1の電極、前記発光層、前記第2の電極が、封止部材によりが封止されていることが好ましい。さらには、前記透明基板の一面側に、前記封止部材を介して前記透明基板に対向する封止基板が設けられていることが好ましい。

【0024】すなわち、発光素子を構成する各電極及び発光層を、樹脂等の封止部材、さらには、透明基板に対向する比較的厚い封止基板により全固体的に密閉封止することにより、透明基板の一面側における物理的な強度が向上する。したがって、透明基板の他面側を、概ね0.2mm以下に薄く形成した場合であっても、透明基板自体の物理的な強度を確保することができるとともに、上記像ぼけや視差ずれを良好に抑制した発光素子を実現することができる。特に、基板面積の増大の要因となる駆動回路を封止基板に設ければ、薄い透明基板の面積をできるだけ小さくすることができ、かつ、透明基板が駆動回路を保持しなくてよいので、透明基板が損壊しにくいという効果を得ることができる。

【0025】また、本発明に係る発光素子は、上記発光素子の構成において、前記発光層から放射される光の出射方向を変更制御する光制御手段を設けた構成を有していることが好ましい。

【0026】すなわち、発光層から放射される光が出射される透明基板の出射面、あるいは、発光層から放射された光を透明基板側へ反射する反射層に、光を散乱する50 光制御手段を設けることにより、発光層から放射される

光のうち、全反射臨界角よりも大きい放射角度を有する 光が、光制御手段による散乱によって出射される。した がって、視野方向への光の取り出し効率を増大すること ができ、より小さなエネルギーで十分な光量を有する発 光素子を実現することができる。ここで、前記光制御手 段は、前記透明基板の他面側に密着するように設けら れ、その密着面における屈折率は、透明基板の屈折率と 同一又は近似しているので、光の取り出し効率をさらに 増大させることができる。

【0027】また、本発明に係る発光素子は、上記発光 10 素子の構成において、前記第2の電極は、少なくとも前記発光層から放射された光を前記透明基板側へ反射する反射特性を有しているものであってもよい。あるいは、前記封止部材の上層に、少なくとも前記発光層から放射された光を前記透明基板側へ反射する反射層を設けたものであってもよい。

【0028】要するに、発光層から放射された光のうち、透明基板とは反対側の後面側に放射された光が、透明基板側へ良好に反射されるものであればよい。これにより、光の取り出し効率をさらに増大させて、より小さなエネルギーで十分な光量を有する発光素子を実現することができる。

【0029】さらに、本発明に係る発光素子は、上記発光素子の構成において、前記透明電極と前記第2の電極との間に、前記第1の電極が、又は、前記第1の電極及び前記発光層が、あるいは、前記第1の電極、前記発光層及び前記第2の電極のいずれもが介在しない領域を有しているものであってもよい。

【0030】すなわち、第1の電極を、例えば、ストラ イプ状に形成することにより、又は、該ストライプ状に 30 形成された複数の第1の電極上に発光層をマトリクス状 に形成することにより、あるいは、第1の電極及び第2 の電極を相互に直交するストライプ状に形成し、発光素 子を該第1及び第2の電極の交点位置にマトリクス状に 形成することにより、透明電極と第2の電極との間に、 第1の電極が、又は、第1の電極及び発光層が、あるい は、第1の電極、発光層及び第2の電極のいずれもが介 在しない領域が形成される。したがって、発光層から放 射された光が第1の電極、又は、第1の電極及び発光 層、あるいは、第1の電極、発光層及び第2の電極のい ずれをも透過することなく透明基板を介して出射される ので、第1の電極、発光層及び第2の電極により吸収さ れて減衰する光量(光の吸収損失)を抑制することがで き、光の取り出し効率を一層増大することができる。

【0031】本発明に係る発光素子の製造方法は、絶縁性の透明基板の一面側に、透明な導電性材料からなる第1の電極と、有機エレクトロルミネッセンス材料からなる発光層と、前記第1の電極に対向する第2の電極を順次積層する工程と、前記透明基板上に積層された前記第1の電極、前記発光層、前記第2の電極の全面を、少な50

くとも封止部材により固体的に封止する工程と、前記透明基板の他面側を研磨して、前記透明基板の厚みを概ね 0.2mm以下にする工程と、を含むことを特徴とす る。

【0032】すなわち、発光素子を構成する各電極及び発光層を、少なくとも樹脂等の封止部材により全固体的に密閉封止した後、透明基板の他面側を研磨することにより、透明基板の物理的な強度を確保しつつ、透明基板が薄く形成(研磨)される。したがって、従来の構成に比較して数分の1程度となる概ね0.2mm以下(好ましくは、0.1mm以下)に良好に薄く形成して、発光層から出射面までの距離を短くすることができ、上記像ばけや視差ずれを良好に抑制した発光素子を実現することができる。

【0033】また、本発明に係る発光素子の製造方法 は、上記方法において、前記研磨された前記透明基板の 他面側に、前記発光層から放射される光の出射方向を変 更制御する光制御手段を密着する工程を有しているもの であってもよい。

20 【0034】すなわち、透明基板の厚みを概ね0.2mm以下に研磨した後、透明基板の出射面側に、透明基板との屈折率の連続性を保持しつつ、光拡散性のフィルタ等の光制御手段が密着して設けられる。したがって、発光層から放射される光のうち、全反射臨界角よりも大きい放射角度を有する光を、光制御手段による散乱によって出射することができるので、上記像ぼけや視差ずれを良好に抑制しつつ、光の取り出し効率を増大して、より小さなエネルギーで十分な光量を有する発光素子を簡易に実現することができる。

[0035]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る発光素子およびその製造方法について、詳しく説明する。図1は、本発明に係る発光素子(有機EL素子)の一実施形態を示す概略図である。ここで、従来技術(図13)と同等の構成については、同一の符号を付して説明する。

【0036】図1に示すように、本実施形態に係る有機EL素子10Aは、有機EL素子を構成する各層が形成される絶縁性基板(透明電極)11aと、透明電極からなるアノード電極(第1の電極)12と、有機化合物等からなる有機EL層(発光層)13と、反射層を構成するカソード電極(第2の電極)14と、上記アノード電極12、有機EL層13及びカソード電極14を積層して構成される有機EL素子の全面を覆う封止層(封止部材)15と、絶縁性基板11aに対向して配置された封止基板16と、絶縁性基板11aの有機EL素子形成側と反対側の面に光学部材17を介して、密着して設けられた散乱板(光制御手段)18と、を有して構成されている。

【0037】絶縁性基板11aは、ガラス又は合成樹脂等の光透過性の高い基板であって、例えば、従来構成

(図13) に示したような絶縁性基板11の板厚(概ね、0.4~0.7 mm)に比較して、数分の1以下となる0.2 mm以下、望ましくは、0.1 mm以下の板厚を有している。この薄い絶縁性基板11 aに対して、一面側(図面下方側)に有機EL素子を構成する各層が形成され、他面側(図面情報側)に散乱板18が設けられる。アノード電極12は、ITO等の透明電極材料により構成され、絶縁性基板11 aの一面側に、所定の形状(パターン)を有して形成される。なお、アノード電極12に適用される電極材料は、ITOに限定されるも10のではなく、透明電極として適用が可能なものであれば、In2O3(ZnO)m(m>0)等の他の材質で

【0038】有機EL層13は、上記アノード電極12上に所定の形状(パターン)を有して積層形成され、従来技術(図13(b))に示したものと同様に、ホール輸送層と電子輸送性発光層が積層された構成を有している。ここで、ホール輸送層としては、例えば、ポリ3、4ーエチレンジオキシチオフェン及びポリスチレンスルフォネート等の高分子系の有機化合物材料を良好に適用することができ、また、電子輸送性発光層としては、例えば、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等の高分子系の有機化合物材料を良好に適用することができる。

あってもよい。

【0039】カソード電極14は、少なくとも上記有機EL層13上に積層されるように、所定の形状(パターン)を有して形成され、例えば、低仕事関数のカルシウム(Ca)(又は、Li、Mg)、及び、低抵抗、光反射性かつ高仕事関数のアルミニウム(A1)(又は、Ag)を積層形成した構成を有し、この積層されたカソード電極14により有機EL層13において放射された光30を特定方向に反射する反射層としての機能を有している。ここで、カソード電極14における光の反射率は、例えば、70%以上となるように、極力高く設定することが好ましい。

【0040】封止層15は、上記アノード電極12、有機EL層13、カソード電極14を積層して構成される有機EL素子の全域を被覆し、さらに、該封止層15を接着層としてガラス基板等からなる封止基板16を、絶縁性基板11aに対向するように貼り合わせることにより、有機EL素子を封止、密閉して、外気から遮断された構成を形成する。ここで、封止層15としては、例えば、エポキシ系の樹脂や、シリコン(Si)とセリウム(Ce)が混成された酸化物を良好に適用することができる。

【0041】ここで、封止層15及び封止基板16による封止構造は、上記絶縁性基板11aを0.2mm以下の板厚に薄く加工した場合であっても、有機EL素子の製造工程における各種処理工程や搬送作業において、破損や不良等を生じない程度の厚さ(又は、強度)を有していることを必要とし、0.4mm以上の厚さのガラス

又は合成樹脂からなる。また、封止基板16は、一面側に有機EL素子の駆動回路(ドライバIC)搭載し、配線等を形成することができる程度の厚さ(又は、強度)を有していることが好ましい。なお、具体的な構成については後述する。

10

【0042】また、散乱板18は、光拡散性を有するフィルムや一面側が粗面化された光透過性部材等の光学手段であって、絶縁性基板11aの他面側に、光学オイル等の光学部材17を介して密着して張り付けられている。ここで、光学部材17の屈折率は、絶縁性基板11aと散乱板18の双方における屈折率の中間値、あるいは、絶縁性基板11a及び散乱板18を、あたかも単一の光学特性を有する構成とする機能を有している。したがって、絶縁性基板11aと散乱板18の界面において、有機EL層13から放射された光やカソード電極(反射層)14からの反射光の、内部方向への反射が抑制され、視野側(絶縁性基板11aの他面側)に良好に出射される。

【0043】すなわち、本実施形態に係る有機EL素子10Aにおいては、有機EL層13に対して光出射側に、板厚0.2mm以下に薄く形成された絶縁性基板11aと、散乱板18が配置され、また、背面側に、反射層となるカソード電極14と、封止層15及び封止基板16が配置された構成を有している。そして、有機EL素子10Aは、固体層からなる上記各層を積層して形成され、全固体デバイスを構成している。

【0044】このような構成を有する有機EL素子10 Aにおいて、従来技術に示したように、アノード電極1 2に相対的に正の電圧、カソード電極14に相対的に負 の電圧を印加することにより、有機EL層13にホール 及び電子が注入され、これらが結合する際の再結合エネ ルギーによって光が放射される。有機EL層13におい て放射された光、及び、カソード電極(反射層)14に おいて反射した光は、透明なアノード電極12、絶縁性 基板11aを介して、絶縁性基板11aの他面側に至 り、絶縁性基板11aの他面側に密着して設けられた散 乱板18により散乱されて、視野側に出射される。

【0045】ここで、本実施形態に適用される光学部材及び散乱板の作用について、図面を参照して具体的に説明する。図2は、本実施形態に係る有機EL素子における光の放射角度と視野側への出射状態との関係を示す概略図であり、図3は、本実施形態に係る有機EL素子における散乱板の張り付け状態と放射光束との関係を示す実測値を示すグラフである。

【0046】本実施形態においては、上述したように、 絶縁性基板11aおよび散乱板18は、双方の屈折率の 連続性を保持する光学オイル等の光学部材17を介して 張り付けられた構成を有している。このような構成にお 50 いては、絶縁性基板11aおよび散乱板18が、略単一

の絶縁性基板と有機EL素子の平面構造を示す概略図で あり、図6は、図4に示した表示装置又は光源の封止基 板側(Y-Y矢視)の平面構造を示す概略図である。こ こで、上述した実施形態と同等の構成については、同一

の光学特性を示すことになるので、図2に示すように、 図14に示した全反射臨界角 α L を有する光し1よりも 大きく、絶縁性基板11aと光学部材17との間で全反 射が生じる光L3の臨界角 α_3 より小さい角度 α_2 で放 射(又は、カソード電極14において反射)される光し 2についても、光学部材17の界面及び散乱板18の界 面で全反射が起こらず散乱されて視野側に出射される。

の符号を付して、その説明を簡略化する。 【0051】図4乃至図6に示すように、本構成例に係

【0047】特に、図3に示すように、絶縁性基板11 aに対して光学オイル等の光学部材17を用いることな く散乱板18を密着させた場合(図3(a))には、概 ね-45°~+45°の放射角度の範囲で視野側に出射 される光束が増大(放射光束の最大が概ね200程度ま で増大)するのに対して、絶縁性基板11aに対して屈 折率の整合性を保持するように光学部材17を介在させ て散乱板18を張り付けた場合(図3(b))には、概 ね-60°~+60°のより広い放射角度のほぼ全範囲 で視野側に出射される光束が大幅に増大(放射光束の最 大が200以上まで増大) することが観測された。

る表示装置又は光源は、上述した実施形態と同様に、概 ね、板厚0.2mm以下に薄く形成された絶縁性基板1 1 a の一面側に、例えば、一方向にストライプ状に複数 条並んで形成されたアノード電極12と、該複数条のア ノード電極12を覆うように形成された単一の有機EL 層13と、例えば、アノード電極12の延在方向とは直 交する方向にストライプ状に複数条形成されたカソード 電極14と、アノード電極12、有機EL層13、カソ ード電極14を順次積層して構成された有機EL素子群 の全形成領域を囲むように設けられ、絶縁性基板11a と後述する封止基板16とを接合する絶縁性のシール部 材21と、該シール部材21を介して絶縁性基板11a に対向して配置され、少なくともシール部材21により 囲まれた空間(有機EL素子を含む)にエポキシ系等の 封止層15を充填して、該空間を封止する封止基板(又 は、対向基板)16と、封止基板16の一面側に所定の パターンで延在するように形成された引き出し電極23 A、23Cと、シール部材21に形成された開口部に充 填され、絶縁性基板側に形成されたアノード電極12及 びカソード電極14と引き出し電極23A、23Cと を、各々個別に電気的に接続するコンタクト電極22 A、22Cと、封止基板16の一面側の所定の位置に配 置され、引き出し電極23A、23Cに電気的に接続さ れた駆動回路(ドライバIC)30と、を有して構成さ

【0048】すなわち、本実施形態に係る有機EL素子 10Aにおいては、光学部材17を介して散乱板18を 密着して配置した構成を有することにより、全反射臨界 角を実質的に大きく(図 2 における角度 $\alpha_L \rightarrow$ 角度 α_S $(> \alpha_2)$) することができるとともに、光の取り出し 効率(すなわち、放射光束)を大幅に向上させることが できる。よって、より小さなエネルギーで十分な光量を 有する発光素子を実現して、表示デバイスやバックライ ト等の光源に良好に適用することができる。

【0049】また、本実施形態に係る有機EL素子10

れている。 【0052】すなわち、マトリクス状に形成された有機 EL素子群は、絶縁性基板11a、シール部材21、封 止基板 16 により形成される空間内にあって、該空間に 封止層15を充填、封止することにより密閉されて、外 気から遮断された構成を有している。また、有機EL素 子群の各アノード電極12及び各カソード電極14は、 各々シール部材21中に形成されたコンタクト電極22

Aの構成によれば、有機EL素子が形成される絶縁性基 板 1 1 a が、概ね 0. 2 m m 以下(望ましくは、0. 1 mm以下)の板厚になるように薄く形成されていること により、有機EL素子10Aを自己発光型の表示デバイ スとして適用した場合には、有機EL層13から放射さ れた光の進路の広がりが、絶縁性基板11aの板厚に相 当する幅に抑制されるので、従来構成(図17)に比較 して、表示画素や画像の輪郭の霞み(画素ぼけや像ぼ け)が抑えられる。一方、有機EL素子10Aを透過型 の表示デバイスの2ウェイバックライトとして適用した 場合には、絶縁性基板の上面とカソード電極の上面との 距離が短くなるので、従来構成(図17)に比較して、 絶縁性基板上面やカソード電極上面において形成される 反射像の水平方向へのずれや重なり (視差ずれ) が抑制 される。よって、画像情報の表示品質に優れた表示装置

A、22C、及び、封止基板16上に形成された引き出 40 し電極23A、23Cを介して駆動回路30に電気的に 接続されている。

【0050】(適用例)次に、上述した有機EL素子を 適用した表示装置又は光源(バックライト)の一構成例 について、図面を参照して説明する。図4は、本実施形 態に係る有機EL素子を適用した表示装置又は光源の一 構成例(構成例1)を示す概略断面図であり、図5は、 図4に示した表示装置又は光源の出射側(X-X矢視)

を実現することができる。

【0053】なお、図示を省略したが、絶縁性基板11 aの他面側(視野側)には、上述した実施形態に示した ように、光学オイル等の光学部材を介して、屈折率の連 続性が保持されるように散乱板が密着して張り付けられ ている。このような構成を有する表示装置又は光源にお いて、駆動回路30から各有機EL素子のアノード電極 12及びカソード電極14に所定の直流電圧が印加され ることにより、有機EL層13において光が放射され、

50 表示駆動、又は、発光駆動が行われる。

【0054】このように、本構成例に係る表示装置又は 光源においては、封止基板16を比較的厚く形成するこ とにより、表示デバイスとしての物理的な強度を確保し つつ、封止基板16側に引き出し電極23A、23Cや 駆動回路30を形成、搭載することができるので、絶縁 性基板11aの板厚を0.2mm以下に極めて薄く形成 することができ、有機EL層13において放射された光 の進路を大幅に短くして、像ぼけや視差ずれの発生を抑 制した良好な表示品質を有する表示装置を提供すること ができる。また、薄く形成された絶縁性基板11aの光 10 するように、所定の位置関係で接続する。 出射側に屈折率の連続性が保持されるように散乱板を設 けることにより、光の取り出し効率を大幅に向上させる ことができるので、省電力かつ高輝度の光源を実現する ことができる。

【0055】(製造方法)次に、上述した表示装置又は 光源に適用される有機EL素子の製造方法について、図 面を参照して説明する。図7、図8は、図4に示した有 機EL素子の製造方法を示す工程断面図である。なお、 以下の説明において、「第1の工程」乃至「第4の工 程」の表記は、説明の都合上、便宜的に用いたものであ 20 って、実際の製造プロセスに関連付けられたものではな い。また、上述した構成例と同等の構成については、同 一の符号を付して説明する。

【0056】まず、第1の工程は、図7(a)に示すよ うに、0.4~0.7mm程度の板厚を有するガラスや 石英、透明な樹脂等からなる絶縁性基板11bの一面側 (図中、下面側) に、スパッタリング法やイオンプレー ティング法等により、IT〇等の透明な電極層を成膜し た後、所定の形状(ここでは、ストライプ状)にパター ニングしてアノード電極12を形成する。その後、真空 30 蒸着法やその他の薄膜形成法により、少なくともアノー ド電極12が形成された領域を覆うように、有機化合物 材料からなるホール輸送層及び電子輸送性発光層を順次 積層して単一の有機EL層13を形成する。

【0057】次いで、第2の工程は、図7(b)に示す ように、有機EL層13上から絶縁性基板11b上に延 在するように、スパッタリング法や蒸着法等により、カ ルシウム及びアルミニウムからなる金属層を所定の形状 に成膜してカソード電極14を形成する。ここで、カソ ード電極14は、例えば、上記ストライプ状に形成され 40 たアノード電極12に対して、直交する方向に延在する ようにストライプ状に形成される。これにより、アノー ド電極12とカソード電極14が有機EL層13を介し て対向するように積層され、図5に示したような有機E し素子群が形成される。

【0058】次いで、第3の工程は、図7(c)に示す ように、0.4mm以上の厚さのガラス又は合成樹脂か らなる封止基板16の一面側(図中、上面側)に所定の パターンを有する引き出し電極23A、23Cを形成し た後、後述する工程において、絶縁性基板11bとの離 50 ので十分に保護することができる。

14 間距離が適切に保たれるような高さを有するシール部材 21を、上記有機EL素子群を囲むように形成する。そ して、シール部材21の所定の箇所に複数の開口部を形 成して、該開口部にコンタクト電極22A、22Cを埋 込形成することにより、コンタクト電極22A、22C と上記引き出し電極23A、23Cが電気的に接続され る。その後、上記有機EL素子群が形成された絶縁性基 板11bの一面側と、引き出し電極23A、23Cやシ ール部材21が形成された封止基板16の一面側を対向

【0059】このとき、図8 (a) に示すように、絶縁 性基板11b、封止基板16及びシール部材21により 形成される空間に封止層15を注入して、全体を固体的 に封止(固化封止)することにより、有機EL素子群は 外気から完全に遮断される。ここで、封止層 15とし て、例えば、エポキシ系やアクリル系の樹脂を用いるこ とにより、有機EL素子群が良好に固化封止されるとと もに、絶縁性基板11bと封止基板16が良好に接着さ れる。また、このとき、シール部材21に埋め込まれた コンタクト電極22A、22Cを介して、絶縁性基板1 1 b 側のアノード電極 1 2 及びカソード電極 1 4 と、封 止基板16側の引き出し電極23A、23Cが個別に電 気的に接続される。

【0060】次いで、第4の工程は、図8(b)に示す ように、絶縁性基板11bの他面側(図中、上面側) を、物理的、又は、化学的なエッチング方法により薄く して、図4に示したような、板厚が0.2mm以下、望 ましくは、0、1mm以下の絶縁性基板11aを有する 表示装置又は光源を形成する。ここで、絶縁性基板11 bを薄く形成する方法としては、機械的な研磨方法やサ ンドブラスタによる物理的なエッチング法、フッ酸によ る科学的なエッチング法を適用することができる。な お、図示を省略したが、薄く形成された絶縁性基板11 aの他面側(図中、上面側)には、上述したように、光 学オイルを塗布して散乱板が張り付けられた構成を有し

【0061】このような有機EL素子の製造方法によれ ば、アノード電極、有機EL層、カソード電極を積層し て構成される有機EL素子を、封止部材及び封止基板に より固化封止した後、絶縁性基板を薄く加工する処理を 行っているので、製造工程における各種処理における外 部応力に対して破損や不良を生じることなく、十分な物 理的強度を確保しつつ、上記実施形態に係る有機EL素 子の構成を良好に製造することができる。これにより、 有機EL層から絶縁性基板の出射面までの距離を短くす ることができるので、上記像ぼけや視差ずれを抑制した 発行素子を良好に実現することができる。また、製造後 の有機EL素子に加わる応力は、その大部分が封止層 1 5及び0. 4mm以上の厚さの封止基板16に集中する

【0062】(他の構成例)次に、上述した実施形態に 係る有機EL素子の他の構成例について、図面を参照し て説明する。なお、以下の各構成例において、上述した 実施形態と同等の構成については、同一の符号を付し て、その説明を省略する。図9は、本実施形態に係る有 機EL素子の他の構成例 (構成例2) の概略構造を示す 図である。

【0063】図9に示すように、本構成例に係る有機E L素子10Bは、板厚0.2mm以下に薄く形成された 絶縁性基板11aの一面側(図中、下面側)に、ストラ イプ状に形成された複数条のアノード電極12と、少な くともアノード電極12が形成された領域を覆うように 形成された単一の有機EL層13と、少なくとも有機E L層13を覆うように形成された、光反射特性を有する 金属層等からなる単一のカソード電極14と、を有して 構成されている。なお、図示を省略したが、アノード電 極12、有機EL層13、カソード電極14から構成さ れる有機EL素子群は、上述した実施形態に示した構成 と同様に、封止部材及び封止基板により固化封止された 構成を有していてもよい。また、絶縁性基板11aの他 20 面側(出射面側)には、光学オイル等の光学部材を介し て散乱板等の光制御手段が設けられた構成を有していて もよい。

【0064】すなわち、本構成例に係る有機EL素子1 0 Bは、絶縁性基板 1 1 a の一面側に積層される有機 E L素子の各構成のうち、アノード電極12を構成するI TO層が形成されていない領域を有している。ここで、 アノード電極12を構成するITO層は、高い光透過性 (透過率)を有するものの、 ITO層を通過する光は、 僅かながらIT〇層内で吸収されて減衰するため、有機 30 EL素子内で複数回にわたって反射した光の光量が低下 する。

【0065】したがって、このような構成によれば、上 述した構成例と同等の作用効果に加え、アノード電極1 2の形成領域以外において、有機EL層13から放射さ れる光haや有機EL素子内で反射した光hbが、IT O層を通過することなく、絶縁性基板11aに到達して 絶縁性基板11aの他面側から出射されるので、ITO 層(アノード電極12)による光の吸収、減衰(光吸収 損失) を抑制して、視野側に出射される光 h v の光量 (光の取り出し効率)を増大させることができ、省電力 で高輝度の発光素子を実現することができる。

【0066】図10は、本実施形態に係る有機EL素子 のさらに他の構成例(構成例3)の概略構造を示す図で ある。図10に示すように、本構成例に係る有機EL素 子10Cは、板厚0.2mm以下に薄く形成された絶縁 性基板 1 1 a の一面側(図中、下面側)に、ストライプ 状に形成された複数条のアノード電極12と、少なくと もアノード電極12が形成された領域を覆うように形成 された複数の有機EL層13と、少なくともアノード電 50 極12及び有機EL層13が形成された領域を覆うよう に形成された、光反射特性を有する金属層等からなる単 一のカソード電極14と、を有して構成されている。な お、図示を省略したが、上述した構成例と同様に、有機 EL素子群は、封止部材及び封止基板により固化封止さ れた構成を有していてもよく、また、絶縁性基板11a の他面側には、散乱板等の光制御手段が設けられた構成 を有していてもよい。

16

【0067】すなわち、本構成例に係る有機EL素子1 0 Cは、絶縁性基板 1 1 a の一面側に積層される有機 E L素子の各構成のうち、アノード電極12を構成するI T〇層及び有機EL層13が形成されていない領域を有 している。ここで、有機EL層13は、上述したアノー ド電極12を構成するITO層と同様に、高い光透過性 (透過率)を有するものの、有機EL層13を通過する 光は、僅かながら有機EL層13内で吸収されて減衰す るため、その光量が低下する。

【0068】したがって、このような構成によれば、上 述した構成例と同等の作用効果に加え、アノード電極1 2及び有機EL層13の形成領域以外において、光が通 過することなく、光反射特性を有するカソード電極14 により良好に反射した光hcが、絶縁性基板11aに到 達して絶縁性基板11aの他面側から出射されるので、 ITO層(アノード電極12)及び有機EL層13によ る光の吸収、減衰(光吸収損失)をさらに抑制して、視 野側に出射される光hvの光量(光の取り出し効率)を より増大させることができ、より省電力でより高輝度の 発光素子を実現することができる。

【0069】図11は、本実施形態に係る有機EL素子 のさらに他の構成例(構成例4)の概略構造を示す図で ある。図11に示すように、本構成例に係る有機EL素 子10Dは、板厚0. 2mm以下に薄く形成された絶縁 性基板11aの一面側(図中、下面側)に、ストライプ 状に形成された複数条のアノード電極12と、少なくと もアノード電極12が形成された領域の所定の位置に形 成された複数の有機EL層13と、ストライプ状に形成 されたアノード電極12の延在方向と直交するように延 在するストライプ状に形成され、少なくともアノード電 極12及び有機EL層13が積層形成された領域を覆う ように形成されたカソード電極14と、アノード電極1 2、有機EL層13、カソード電極14から構成される 有機EL素子群の全域を覆うように保護する透明なパッ シベーション膜15aと、パッシベーション膜15aの 全域を覆うように形成された光反射特性を有する金属層 等からなる単一の反射層19と、を有して構成されてい

【0070】ここで、カソード電極14は、ITO等の 透明な電極材料により形成されている。また、図示を省 略したが、絶縁性基板11aの他面側には、散乱板等の 光制御手段が設けられた構成を有していてもよい。な

20

18

お、光制御手段は、絶縁性基板11aの他面側に設ける 構成に限らず、反射層19の表面を粗く加工することに より、散乱板と同等の光拡散性を付与した構成であって もよい。すなわち、本構成例に係る有機EL素子10D は、絶縁性基板11aの一面側に積層される有機EL素 子の各構成のうち、アノード電極12とカソード電極1 4が互いに直交する格子状に形成され、また、有機EL 層13がその格子点(交点)に形成された構成を有して いるため、アノード電極12、有機EL層13及びカソ ード電極14のいずれもが形成されていない領域を有し ている。

【0071】したがって、このような構成によれば、上 述した構成例と同等の作用効果に加え、アノード電極1 2、有機EL層13及びカソード電極14の形成領域以 外においては、光の吸収、減衰(光吸収損失)が抑制さ れるとともに、有機EL層13の背面側 (図面下方) に 放射された光hdや有機EL素子内で反射した光hbが 反射層19により良好に反射、散乱されて絶縁性基板1 1 a に到達して出射されるので、視野側に出射される光 hνの光量(光の取り出し効率)をさらに増大させるこ とができ、より省電力でより高輝度の発光素子を実現す ることができる。

【0072】図12は、本実施形態に係る有機EL素子 のさらに他の構成例(構成例5)の概略構造を示す図で ある。図12に示すように、本構成例に係る有機EL素 子10Eは、板厚0.2mm以下に薄く形成された絶縁 性基板11aの一面側(図中、下面側)に、ストライプ 状に形成された複数条のアノード電極12と、少なくと もアノード電極12が形成された領域の所定の位置に形 成された複数の有機EL層13と、ストライプ状に形成 されたアノード電極12の延在方向と直交するように延 在するストライプ状に形成され、少なくともアノード電 極12及び有機EL層13が積層形成された領域を覆う ように形成されたカソード電極14と、アノード電極1 2、有機EL層13、カソード電極14から構成される 有機EL素子群の全域を覆うように封止する透明な封止 **層15と、光反射特性を有する金属層等からなる単一の** 反射層19が形成されるとともに、絶縁性基板11aに 対向して配置された比較的厚い封止基板16と、を有し て構成されている。

【0073】ここで、上述した構成例と同様に、カソー ド電極14は、ITO等の透明な電極材料により形成さ れている。また、図示を省略したが、絶縁性基板11a の他面側には、散乱板等の光制御手段が設けられた構成 を有していてもよく、また、反射層19の表面を粗く加 工することにより、散乱板と同等の光拡散性を付与した 光制御手段を有するものであってもよい。すなわち、本 構成例に係る有機EL素子10Eは、アノード電極12 とカソード電極14が互いに格子状に形成され、また、 有機EL層13がその格子点に形成された構成を有して 50 ができるとともに、上記像ぼけや視差ずれを良好に抑制

いるため、アノード電極12、有機EL層13及びカソ ード電極14のいずれもが形成されていない領域を有し ている。

【0074】したがって、このような構成によれば、上 述した構成例と同等の作用効果に加え、有機EL素子が 形成された絶縁性基板11aに対向して、比較的厚い封 止基板16が設けられているので、十分な物理的強度を 確保することができ、製造工程における各種処理におけ る外部応力に対する破損や不良の発生を抑制することが できる。

【0075】なお、上述した各実施形態においては、有 機EL層から放射される光の取り出し効率を向上させる ための構成として、絶縁性基板の出射面側に散乱板等の 光制御手段を設けた構成を示したが、本発明は、これに 限定されるものではない。要するに、有機EL層から放 射される光の進路(進行方向)を変化させて、視野側に 出射させるものであればよく、例えば、絶縁性基板の出 射面側の表面を粗く加工(いわゆる、フロスト加工)し て散乱面を構成するものであってもよいし、有機EL層 から放射される光を反射するカソード電極や反射金属層 の表面を粗く加工して、有機EL素子の内部で散乱を生 じさせるものであってもよい。このような構成によれ ば、絶縁性基板の出射面側に散乱板等を設ける必要がな いため、製造工数を削減して簡易に光の取り出し効率が 高く、高輝度の有機EL素子を提供することができる。 [0076]

【発明の効果】本発明に係る発光素子によれば、出射光 側となる透明基板を薄く構成(概ね0.2mm以下、好 ましくは、0.1mm以下に)することにより、発光素 子を自己発光型の表示デバイスに適用した場合には、発 光層から出射面(透明基板の他面側)までの距離が短く なり、発光層から放射された光の進路の拡がりが抑制さ れるので、表示画素のぼけ(像ぼけ)を抑制することが でき、画質を向上した表示デバイスを実現することがで

【0077】また、発光素子を透過型表示デバイスの2 ウェイバックライトとして適用した場合においては、透 明電極の上面から反射層となる第2の電極までの距離が 短くなり、透過型表示デバイスに表示された画像の反射 像のずれや重なりが抑制されるので、視差ずれを抑制す ることができ、画質を向上した表示デバイスを実現する ことができる。

【0078】また、上記発光素子の構成において、発光 素子を構成する各電極及び発光層を、樹脂等の封止部 材、さらには、透明基板に対向する比較的厚い封止基板 により全固体的に密閉封止することにより、透明基板の 一面側における物理的な強度が向上するので、透明基板 の他面側を、概ね0.2mm以下に薄く形成した場合で あっても、透明基板自体の物理的な強度を確保すること

した発光素子を実現することができる。

【0079】また、上記発光素子の構成において、発光層から放射される光が出射される透明基板の出射面、あるいは、発光層から放射された光を透明基板側へ反射する反射層に、光を散乱する光制御手段を設けることにより、発光層から放射される光のうち、全反射臨界角よりも大きい放射角度を有する光が、光制御手段による散乱によって出射されるので、視野方向への光の取り出し効率を増大することができ、より小さなエネルギーで十分な光量を有する発光素子を実現することができる。ここ 10で、光制御手段は、透明基板の他面側に密着するように設けられ、その密着面における屈折率は、透明基板の屈折率と同一又は近似しているので、光の取り出し効率をさらに増大させることができる。

【0080】さらに、上記発光素子の構成において、発光層から放射された光のうち、透明基板とは反対側の後面側に放射された光が、透明基板側へ良好に反射されるように反射層を形成することにより、光の取り出し効率をさらに増大させることができ、より小さなエネルギーで十分な光量を有する発光素子を実現することができる。

【0081】さらに、上記発光素子の構成において、第 1の電極を、例えば、ストライプ状に形成することによ り、又は、該ストライプ状に形成された複数の第1の電 極上に発光層をマトリクス状に形成することにより、あ るいは、第1の電極及び第2の電極を相互に直交するス トライプ状に形成し、発光素子を該第1及び第2の電極 の交点位置にマトリクス状に形成することにより、透明 電極と第2の電極との間に、第1の電極が、又は、第1 の電極及び発光層が、あるいは、第1の電極、発光層及 30 び第2の電極のいずれもが介在しない領域が形成される ので、発光層から放射された光が第1の電極、又は、第 1の電極及び発光層、あるいは、第1の電極、発光層及 び第2の電極のいずれをも透過することなく透明基板を 介して出射することにより、第1の電極、発光層及び第 2の電極により吸収されて減衰する光量(光の吸収損 失)を抑制することができ、光の取り出し効率を一層増 大することができる。

【0082】本発明に係る発光素子の製造方法によれば、発光素子を構成する各電極及び発光層を、少なくと 40 も樹脂等の封止部材により全固体的に密閉封止した後、透明基板の他面側を研磨することにより、透明基板の物理的な強度を確保しつつ、透明基板が薄く形成(研磨)されるので、従来の構成に比較して数分の1程度となる概ね0.2mm以下(好ましくは、0.1mm以下)に良好に薄く形成して、発光層から出射面までの距離を短くすることができ、上記像ぼけや視差ずれを良好に抑制した発光素子を実現することができる。

【0083】また、上記方法において、透明基板の厚み を概ね0.2mm以下に研磨した後、透明基板の出射面 50 側に光拡散性のフィルタ等の光制御手段が密着して設けられるので、発光層から放射される光のうち、全反射臨界角よりも大きい放射角度を有する光を、光制御手段による散乱によって出射することができ、上記像ぼけや視差ずれを良好に抑制しつつ、光の取り出し効率を増大して、より小さなエネルギーで十分な光量を有する発光素子を簡易に実現することができる。

20

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る発光素子の一実施形態を示す概略 図である。

【図2】本実施形態に係る有機EL素子における光の放射角度と視野側への出射状態との関係を示す概略図である。

【図3】本実施形態に係る有機EL素子における散乱板の張り付け状態と放射光束との関係を示す実測値を示す グラフである。

【図4】本実施形態に係る有機EL素子を適用した表示 装置又は光源の一構成例(構成例1)を示す概略断面図 である

20 【図5】図4に示した表示装置又は光源の出射側(X-X矢視)の絶縁性基板と有機EL素子の平面構造を示す 概略図である。

【図6】図4に示した表示装置又は光源の封止基板側 (Y-Y矢視) の平面構造を示す概略図である。

【図7】図4に示した有機EL素子の製造方法における 第1乃至第3の工程を示す各工程断面図である。

【図8】図4に示した有機EL素子の製造方法における 第4の工程を示す工程断面図である。

【図9】本実施形態に係る有機EL素子の他の構成例 (構成例2)の概略構造を示す図である。

【図10】本実施形態に係る有機EL素子のさらに他の 構成例(構成例3)の概略構造を示す図である。

【図11】本実施形態に係る有機EL素子のさらに他の 構成例(構成例4)の概略構造を示す図である。

【図12】本実施形態に係る有機EL素子のさらに他の 構成例(構成例5)の概略構造を示す図である。

【図13】従来技術における有機EL素子の概略構成を 示す断面図である。

【図14】有機EL素子内部における光の進路と、視野側への出射角度との関係を示す図である。

【図15】有機EL素子の放射特性と、全反射臨界角との関係を示す図である。

【図16】従来技術における有機EL素子の光の取り出し効率を向上させた構成を示す図である。

【図17】従来技術における有機EL素子の問題点を説明するための概略図である。

【符号の説明】

10、10A~10E 有機EL素子

11a、11b 絶縁性基板

12 アノード電極

	有機EL層	18	散乱板
	カソード電極	1 9	反射層
_	パッシスーション時	9 1	2. 11.1

15a パッシベーション勝15 封止層

1 6封止基板1 7光学部材

1 3

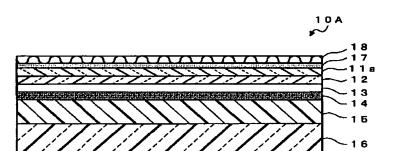
1 4

21 シール部材

22A、22Cコンタクト電極23A、23C引き出し電極

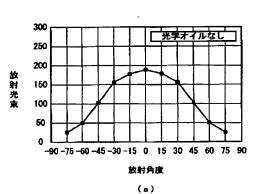
30 駆動回路

【図1】

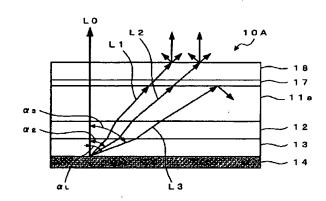


【図3】

22



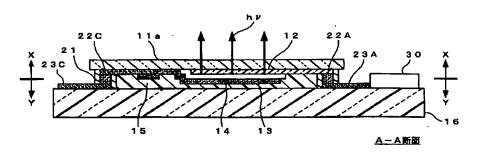
【図2】

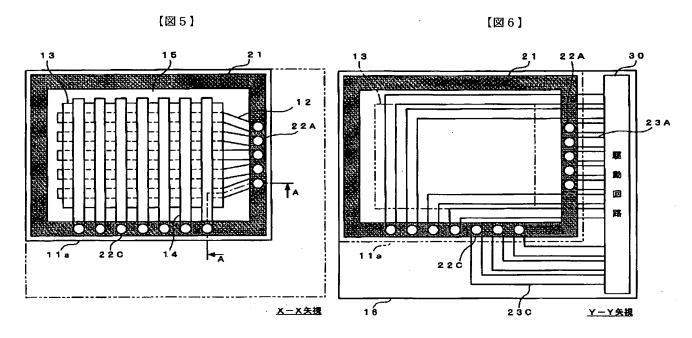


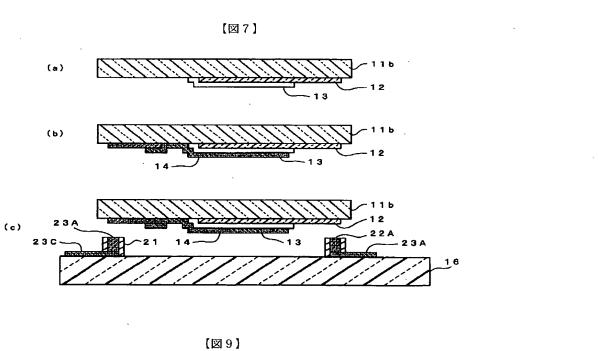
数 計 250 250 250 250 乗 150 200 -90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 放射角度

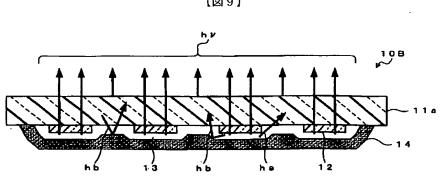
(b)

[図4]

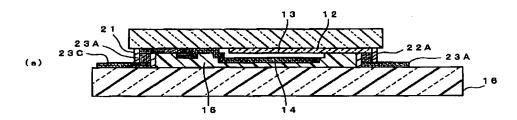


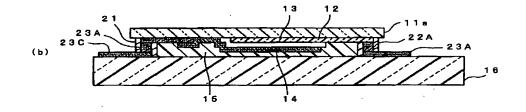




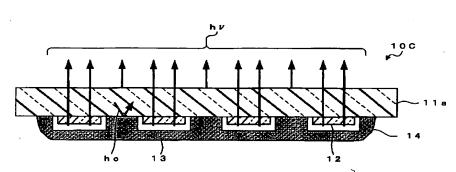


【図8】

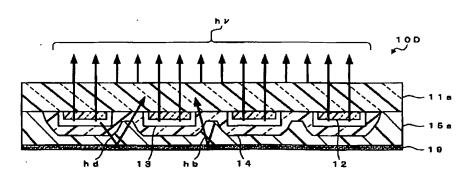




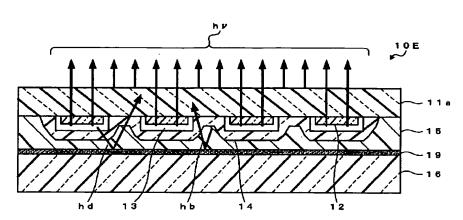
【図10】



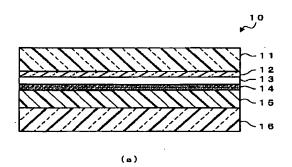
【図11】



【図12】

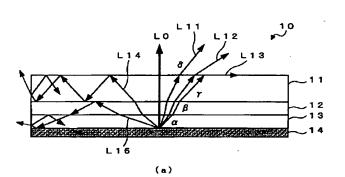


【図13】



Vpc (b)

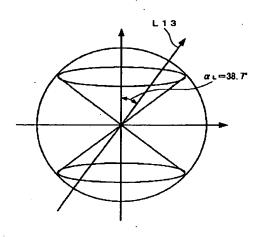
【図14】



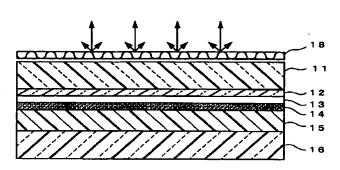
	α	β	r	8
LO	0,	0,	0,	٥,
L11	26. 3°	20. 7°	29. 2*	45*
L 1 2	37. 2°	28, 9"	41.8°	75°
L13	38. 7*	30. 0°	43. 6°	90°
L14	>38. 7°	_	-	* 1
L15	>65°	-	* 2	

- : 絶縁性基板11の上面において反射 : アノード電極12と絶縁性基接11の界面において反射

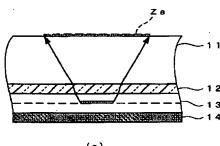
【図15】



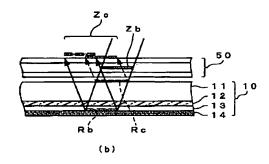
【図16】



【図17】



(a)



フロントページの続き

(72)発明者 岡田 修

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシ 才計算機株式会社八王子研究所内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB17 AB18 BA06 BB07

CA01 CA05 CB01 DA01 DB03

EA01 EB00 FA01 FA02